

Рынок	30
6 «КБ Навис»: серийность, мультисистемность, конкурентоспособность	
9 Знакомьтесь: ОАО «Завод полупроводниковых приборов»	32
	34
12	
21	39 Боладжи Оджо Не такие уж и пассивные компоненты
25	42 Борис Большиков, Алексей Халявин, Василий Барган Наноконденсатор: новый подход к получению унифицированных керамических емкостных элементов
28	46 Павел Усачев Современные инновационные решения для высококачественных разъемов
	52 Кендал Кастор-Перри Полосовой фильтр: не пренебрегайте катушкой

56 Константин Калаев

Линейность и шумовые характеристики резисторов Vishay, изготовленных по технологии Bulk Metal® Foil

Константин Калаев

58 Леонид Акиншин

О новизне процессоров Intel Core i3/i5/i7. Часть 2

Леонид Акиншин

62 Виктор Охрименко

FSK-модемы для PLC-связи: стандарты, производители, компоненты

68 Грэг Лара

Создание периферийных устройств с поддержкой PCI Express на основе FPGA

Грэг Лара

72 Дейв Коулман, Майкл Мирмак

Моделирование компонентов шины Intel QPI

78 Леонид Авгуль, Борис Иванов, Виктор Кряжев, Сергей Курносенко, Сергей Терешко

Микросхема быстродействующего восьмиразрядного буферного формирователя 5861АП1У

80 Владимир Кондратьев

OLED-технология — перспективное решение для систем освещения?

ПОСЛЕ РАБОТЫ

85 Сергей Слепнев

Цифровой USB-термометр BM1707 с мониторингом температуры через интернет

87 Тон Гисбертс, Тейс Бэкерс

Альтернативный источник питания для Hi-Fi-систем

89

Тон Гисбертс, Тейс Бэкерс

Тон Гисбертс, Тейс Бэкерс